Początek formularza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia: | **Modułowa stacja pomiarowa do badania grubości powłok FISCHERSCOPE MMS PC2 Base Unit oraz przenośne urządzenie do badania grubości powłoki Cu SR-SCOPE RMP30** Nr ewidencyjny 479-1058-PMf-57 |
|  | Producent: | Helmut Fischer GmbH |
|  | Model/typ: | MMS PC2 |
|  | Wyposażenie: |  |
|  | Numer fabryczny: | 100/100108210 |
|  | Rok produkcji: | 2019 |
|  | Data zakupu: | 20.12.2019 |
|  | Data przyjęcia na stan środków trwałych: | 30.12.2020 |
|  | Stawka amortyzacyjna  Wartość urządzenia/aparatury na dzień… | Stawka amortyzacyjna – 14%  Wartość brutto urządzenia/aparatury: 69.013,50  Umorzenie urządzenia/aparatury na dzień : 31.07.2024 – 34.621,79  Wartość netto urządzenia/aparatury na dzień 31.07.2024 – 34.391,71 |
|  | Lokalizacja: | Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny, 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11 |
|  | Przeznaczenie urządzenia: | Zastosowanie: Pomiar grubości miedzi w otworach przelotowych o średnicach od 0,8 mm, grubości powłok lakierniczych na laminatach o zakresie nie mniejszym niż 0-1200 µm oraz grubości miedzi na laminatach w zakresie nie mniejszym niż 0,1 - 120 µm w obwodach drukowanych dla projektów badawczych i badawczo-rozwojowych /materiały i elektronika samochodowa, użytkowa, lotnicza i specjalna, w tym do zastosowań kosmicznych/  Usługi: Badanie grubości powłoki miedzianej oraz soldermaski  Cechy unikatowe: Podstawowe urządzenie do kontroli jakości. Pozwala na codzienną, szybką kontrolę międzyoperacyjną i końcową obwodów drukowanych. Natychmiastowe wyniki w porównaniu do zgładów metalograficznych dają możliwość szybszej reakcji na wykrycie możliwych nieprawidłowości w procesie.  Unikatowość: Tak  Niezależna od zestawu  Dane techniczne: Stacja MMS PC2 posiada podłączone następujące moduły pomiarowe: 1. moduł do pomiaru grubości Cu w otworach obwodów drukowanych zmodyfikowaną metodą prądów wirowych. Zakres pomiarowy 5 - 80 μm w otworach 0,8 - 2,0 mm w płytach o grubości 0,7 - 2,5 mm. 2. moduł do pomiaru grubości Cu na laminatach cienkich i obwodach wielowarstwowych metodą mikro rezystancji. Urządzenie pracuje w dwóch zakresach: zakres 1: 0,1-10 μm, zakres 2: 5-120 μm. 3. moduł do pomiaru grubości soldermaski na podłożu miedzianym metodą amplitudową prądów wirowych. Przenośne urządzenie RMP30 to oddzielny moduł do pomiaru grubości Cu na laminatach cienkich i obwodach wielowarstwowych metodą mikro rezystancji. |
|  | Stan techniczny: Wybierz (b. dobry, dobry, przeciętny, słaby ) | b. dobry |
| 13 | Cel wyceny: | Wkład rzeczowy do projektu KPO |
| 14 | Dane kontaktowe | Stefan Galiński |
| 15 | nr tel. | 22/590-73-98 |
| 16 | Email: | stefan.galinski@it.lukasiewicz.gov.pl |